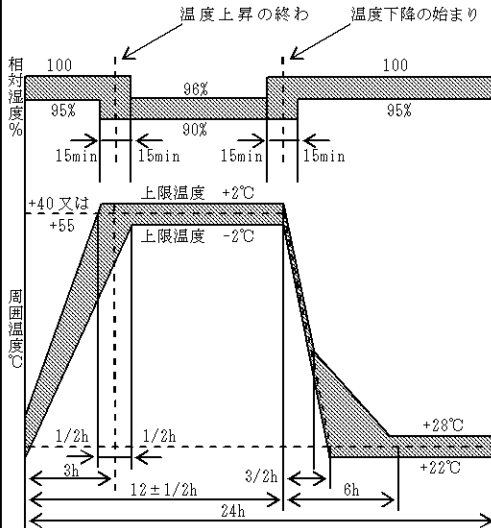


適用規格		SD Card Specifications Ver 1.0			
定 格	使用温度範囲	-25 °C ~ +85 °C(注1)	保存温度範囲	-40 °C ~ +85 °C	
	電 圧	AC 125 V	使用湿度範囲	相対湿度95%以下 (ただし、結露しないこと。)	
	電 流	0.5 A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観・構造・仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	低電圧、低電流下の接触抵抗 IEG60512-2-2a	開放電圧20 mV、試験電流1 mA で測定する。	100mΩ以下（初期値）（注2）	○	—
	耐 電 圧 IEG60512-2-4a	AC 500Vrmsの電圧を1分間印加する。	①せん絡・絶縁破壊がないこと。 ②漏洩電流 1 mA以下	○	—
	絶 縁 抵 抗 IEG60512-2-3a	DC 500Vの電圧を印可し1分以内に測定する。	1000MΩ以上（初期値）	○	—
機 械 的 性 能	カード挿入操作力	スリット25mm/minにて適合カードで測定する。	初期：10N以下 挿抜寿命後：10N以下	○	—
	挿抜寿命 (オフィス環境) EIA364b class1.1	毎時400~600回の速度で、10,000回の挿抜を行う。	①接触抵抗：初期からの変化量40mΩ以下 (挿抜により接触抵抗値が復帰すれば可) ②極度の摩耗や破損等の異常がないこと。	○	—
	振動・高周波 IEG60512-4-6d	片振幅0.75mm、周波数10~55~10Hzの振動をX、Y、Z軸3方向各2時間加える。	①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	衝 撃 IEG60512-4-6c	加速度490m/s ² 、持続時間11msの正弦半波で3軸方向各3回の衝撃を加える。	①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温湿度サイクル IEG60512-6-11m	1サイクル 24時間で 10サイクルの嵌合放置をする。 	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—
	△の数		訂正記事	設計	検図
△					
備考（注1）通電による温度上昇を含む。 （注2）接触抵抗は導体抵抗を含む。 規定無き場合は温度15°C~35°C、気圧86~106kPa、湿度25~85%の試験環境下にて実施のこと。			承認	KI.AKIYAMA	06.03.10
			検 図	SI.TOMIOKA	06.03.10
			担 当	HT.SUGIMURA	06.03.10
			製 図	HM.SAITO	06.03.10
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-153736-06		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DM1AA-SF-PEJ(72)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL609-0004-8-72	0△1/2

性		能			
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
環 境 的 性 能	熱 衝 撃 IEC60512-6-11d	温度 -55～ +85℃、変化時間 5分以内で 5サイクル（1サイクル＝1h）の嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—
	耐 熱 性 IEC60512-6-11i	温度 +85℃に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—
	耐 寒 性 IEC60512-6-11j	温度 -25℃に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—
	耐 湿 （定常状態） IEC60512-6-11c	温度+40℃、湿度 90～95%RH中に96hの嵌合 放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—
	硫化水素ガス JEIDA 38	温度+40℃、湿度80%RH、H ₂ S 3ppmのガス中に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—
	塩 水 噴 霧 JIS G 5402 7.1	温度35±2℃、5±1%の塩水噴霧中に48時間 の嵌合放置をする。（後処理：塩の付着物を水 洗い後、室温に24時間放置）	①機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○	—
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-153736-06		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DM1AA-SF-PEJ (72)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL609-0004-8-72	△ 2/2